⑩特許出願公開

#### 平2-232915 @ 公 開 特 許 公 報(A)

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)9月14日

H 01 G

3 2 1 3 5 8

7048-5E 7924-5E X

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

60発明の名称

チップ型LC複合セラミツクス部品

创特 頭 平1-52765

願 平1(1989)3月7日 29出

原 明者 北 個発

直人

埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 三菱鉱業セメント

株式会社セラミツクス研究所内

秀 晃 @発 明 者 和 田

埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 三菱鉱業セメント

株式会社セラミツクス研究所内

個発 明 者 村 正己 越

埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 三菱鉱業セメント

株式会社セラミックス研究所内

三菱鉱業セメント株式

東京都千代田区丸の内1丁目5番1号

会社

弁理士 倉 持 個代 理 人

最終頁に続く

願 人

の出

1、発明の名称

チップ型LC複合セラミックス部品

2. 終終額束の範囲

(1) 内部導体層と誘電体層を積層して構成される 少なくとも1つのキャパシタ機能と、少なくと も1つのインダクタ機能を有するチップ型LC 複合部品において、

その誘電率が20以上で、透磁率が1.より大 きな複合セラジャクス材料を用いたことを特徴 とするチップ型LC複合セラミックス部品。 OD前記複合セラミックス材料は、マンガン、 ニッケル、マグネシウム、コバルト、銅、亜鉛 及び飲からなる群より選択される少なくとも 1 つの金属元素Mを有する一般式MFe<sub>1</sub>0<sub>4</sub>の組 成式で示されるフェライトと、チタン酸パリウ ムBaTiO。、チタン酸鉛PbTiO。、チタ ン酸ストロンチウムSェTiO。からなる群よ り選択される少なくとも1つの誘電体化合物と を含有する組合焼結体であることを特徴とする

請求項第1項記載のチップ型して複合セラミッ クス部品。

3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

木発明は、キャパシタ機能とインダクタ機能の 両機能を有するチップ型LC複合セラミックス部 品に関する。

#### [従米の技術]

従来、キャパシタ機能とインダクタ機能を同一 チップ内に内蔵することにより集積回路基板全体 を小型化しようとすることが盛んに行なわれてき たが、キャパシタ機能を出すための額電性とイン ダクタ機能を出すための磁性とを共に有するセラ ミックス材料がなかったため、キャタシタ機能波 いはインダクタンス機能を関別に有する精層ゼラ ミックス体を個別に焼成し接合する、若しくは、 阿時に焼成することにより、チップ型LC複合セ ラミックス部局を形成したものであった。然し乍 ら、このようなチップ型 L C 複合セラミックス部 品は、異種の材料を少なくとも2つ以上用いたも

のであったため、製造工程が複雑で、更に誘電体 層と磁性体層が同一面でなければならないという 問題等があった。

#### [発明が解決しようとする問題点]

本発明は、以上述べた従来のチャブ型して複合セラミックス部品に見られる問題を解決し、誘電性と磁性の両機能を有する複合セラミックス材料を用いることにより、1つの観閲セラミックス基板内にキャバシタ機能とインダクタ機能の両方を有するチャブ型して複合セラミックス部品を提供することを目的とする。

#### [発明の構成]

#### [問題点を解決するための手段]

本発明の要旨とするものは、内部導体機と誘電体層を積層して構成される少なくとも1つのキャバシタ機能と、少なくとも1つのインダクタ機能を有するチャブ型LC複合部品において、その誘電率が20以上で、透磁率が1より大きな複合セラミックス材料を用いたことを特徴とするチャブ型LC複合セラミックス部品である。その複合セ

ミックス体を形成したものである。従って、磁性と誘導性の両方を有するセラミックス材料を疑問体として用いて、インダクタとキャバシタの両方の素子を有するテップ型LC複合セラミックス、その複合セラミックス材料の勝電車は、20以下の表を避して、大力の形成が困難となり、不都合であり、透磁率は、が困難となり、不都合であり、チップ型LC複合セラミックス部品に適さない複合セラミックス部品に適さない複合セラミックス部品に適さない複合セラミックス部品に適さない複合セラミックス科料となる。

本発明のチェブ型して複合セラミックス部品構造の1つによると、キャパシタ機能を有する積層内部電極とコイル状内部導電体を、高い調電性と磁性の両方の特性を有する複合セラミックス体中に形成したことで、小型化できるチップ型して複

ラミックス材料は、マンガン、ニッケル、マグネシウム、コバルト、銅、亜鉛及び飲からなる群より選択される少なくとも1つの金属元常Mを有する一般式MFe。O。の組成式で示されるフェライトと、チタン酸バリウムBaTIO。、チタン酸鉛PbTiO。、チタン酸ストロンチウムSrTiO。からなる群より選択される少なくとも1つの誘電体化合物とを含有する複合統結体が好適である。

#### [作用]

本発明によると、上記の目的を遊成するため、 誘電性と磁性の両方を有する複合セラミックス材料として、一般式MFe<sub>1</sub>O<sub>1</sub>(Mは、マンガン、 ニッケル、マグネシウム、コパルト、銅、頭釣及 び飲からなる群より選択される少なくとも1つの 金属元素である)で示されるフェライトと、チタン として、チタン酸 ストロンチウム SェTiO<sub>1</sub> から なる群より選択される少なくとも1つの誘電体化 合物とを含有する混合焼結体を用いて、積層セラ

合セラミックス部晶を提供する。

また、複合セラミックス体は、粒径30~12 0μmのチタン酸系跡で体とフェライト系磁性体 とを混合した、所謂、磁性誘導体の複合セラミッ クス体を基板として用いた構造のものである。

本発明の積層複合セラミックス体は、チタン酸パリウムBaTiO。、チタン酸鉛PbTiO。、チタン酸鉛PbTiO。、チタン酸鉛PbTiO。、チタン酸公トロンチウムSrTiO。からなる群より選択される少なくとも1つの誘電体化合物とNi-Zn系フェライト化合物を混合配合した組成体を複合セラミックス体基板として用いる。それに対して、金Au、銀Ag、銅Cu、パラジウムに対して、金Au、銀Ag、銅Cu、パラジウの金属を主収分とする厚膜導体ペーストを用いて砂度される内部導体層を積層して、そしてコイル状に配置して、焼成した少なくとも1つのキャパシタ機能と少なくとも1つのインダクタ機能の両機能を有する新層複合セラミックス体であるものが野適である。

また、コンデンサの内部電極の材質は、電気伝

事度がよく、耐熱性、耐袋性が良いPdを主成分とする事理性薄膜材質を利用できるが、それらに 限定されるものではない。電視形成法について は、印刷法等が利用できる。

本発明によるキャパシタ機能とインダクタ機能を有する内部電極の接続されるべき両端子は、外部電極形成を利用するが、その電極作製法は、その端面表面に導電性ベーストを監布し、焼付ける方法或いは場面に種々の方法で形成した導電性存製面を電極として使用する方法などがある。

本発明に利用する種層複合セラミックス体部品の製法は、特に限定されるものではないが、上記に説明した複合セラミックス材料について、セラミックスシートを形成し、導電性ペーストを印刷した後、被層してセラミックス体を形成し、焼成する方法、ペースト状にした複合材料と導電性ペーストを互いに印刷積層し、セラミックス体を形成し、焼成する方法などがあり、他は特に限定されるものではない。

d 等の導電性ペーストにより、所領のキャバスタンス及びインダクタンス分が形成されるように、印刷積層し、1.250℃程度で4~10時間程度焼成して積層セラミックス体を得た。キャパンタンス及びインダクタンスの両端子が積層セラミックス体の外表面にあるようにする。このようにして得られた積層セラミックス体外表面のキャバシタ及びインダクタの両端子部分に外部電極用の導電性ペーストを印刷又はディップし、50.0~80℃程度で焼成して外部電極を形成し、所望のナップ型LC複合セラミックス部品を得る。

次に、本発明のチップ型LC複合セラミックス 邸品の構造を説明する。

第1図 a の斜視図は、本発明のチップ型 L C 複合セラミックス部品を示す。そこで示す A - A ・ 面、 B - B ・ 面、 C - C ・ 面、 D - D ・ 面及び E - B ・ 面に沿って切断した断面図を各々第2図 a、 b、 c、 d 及び e に示す。そして、第1図 a のチップ型 L C 複合セラミックス部品の等価回路

#### [ 灾施例]

NiCO<sub>1</sub>、ZnO、Fe<sub>1</sub>O<sub>1</sub>を出発原料として、これらをモル比で、NiO:ZnO:Fe<sub>1</sub>O<sub>1</sub>=3:7:10になるように混合し、1000°Cで仮焼し、更に粉砕して、(Nio...Zn<sub>1</sub>,)Fe<sub>1</sub>O<sub>4</sub>粉末を得る。一方、BaCO<sub>1</sub>、TiO<sub>1</sub>を出発原料として、これらをモル比でBaCO<sub>1</sub>:TiO<sub>1</sub>=1:1になるように混合し、1150°C程度で仮焼し、更に粉砕してBaTiO<sub>1</sub>粉末を得る。

次に、得られた(Ni.i.Zn...)Pe.O.粉 求とBaTiO.粉末を、所定量割合で混合し、 有機パインダーを添加して誘電体と磁性体の混合 ペーストを作載する。その後、Pd又はAg/P

図を第1図 b に示す。即ち、第1図 a に示すチャプ型 L C 複合セラミックス部品では、誘電体と磁性体の複合セラミックス材料 1 と、A g / P d の厚護導体ペーストで形成したキャパシタを形成する対向電極 2、3及びインダクタを形成する電極 4 とを経験した構造を有するものである。

その内部構造は、第2図a、b、c、d、eの各断値図に示すものである。即ち、チップ型LC複合セラミックス部晶の上半分の内部には、積層コンデンサ構造を有するものである。即ち、第2図aに示す断値のように、各々外部電極2、3を引きる。更に、チップ型LC複合セラミックス部晶の下半分には、インダクタ構造、即ち、内部準体4をコイル状に存在する内部構造を有する複合セラミックス体よりなるものである。そして、コイル状内部導体4は、外部電極5-3、5-2に接合されている。

次に、各種フェライトと各種関電体材料を複合 して作製したセラミックス材料について、第3回 透磁率の関係を示した。

即ち、上記の積層複合セラミックス体1中に、キャパシタ機能を有する2種の内部電極2、3を 形成し、その内部電極2、3を外部電極5に接合 し、第1図 bの等価回路図のコンデンサ 6 を形成 し、そして、磁性体1内に、コイル状に内部導電 体を形成し、第1図 bのインダクタンス7を形成 した構造のものである。

更に、本発明のチャブ型しC複合セラミックス 部品の外部面に外部電極 5 - 1、5 - 2、5 - 3 を印刷形成し、或いは更にチップ部分、例えばト ランジスタ等を搭載し、複合回路、ハイブリッド 回路基板を製作できる。

複合するフェタイトと誘電体化合物の種類及び 混合割合は、形成するインダクタ及びキャパンタ の L 分及び C 分の大きさによって、形成するチャ ブの大きさを 数小にできるように選択することが できる。

#### [発明の効果]

本発明のチップ型LC複合セラミックス部品

第4 図は、更に本発明のチップ型 L C 複合セラミックス 部品に用いるチタン酸ストロンチウムと各種フェライトの組成割合に対する誘電率及び透磁率の依存性を示すグラフである。

第5回は、更にチタン酸鉛と各種フェライトの 組成割合に対する誘電率及び透磁率の依存性を示 すグラフである。

[主要部分の符号の説明]

1.....フェライトと誘電体の

複合セラミックス体

2、3......内部電板

4....インダクタンス専電体

5 . . . . . . . 外部電極

特許出願人 三菱鉱業セメント株式会社 代理人 弁理士 倉 持 裕 は、その構造により、

が1に、チップ型して複合セラミックス部品に 誘電体特性と磁性特性を有する複合セラミックス 体材料を用いることにより、部品の小型化が容易 である構造を提供することができること、

第2に、チップ型LC複合セラミックス部品の 製造工程の筒略化が可能であり、コスト低下の可 能な構造を提供したこと、

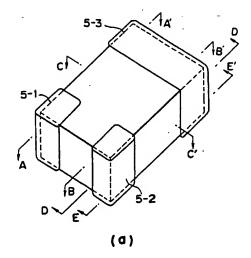
などの技術的な効果が得られた。

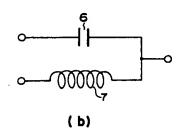
#### 4. 図面の簡単な説明

第1図a、bは、本発明のチップ型LC複合セラミックス部局の構造の1例を示す斜視図及びその労価回路図である。

第2図a、b、c、d、eは、第1図aに示す 各断面に沿う断面図である。

第3 図は、本発明のチップ型 L C 複合セラミックス部品に用いるチタン酸バリウムと各種フェライトの組成割合に対する誘電率及び透磁率の依存性を示すグラフである。

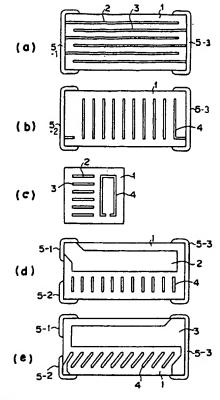




第1図

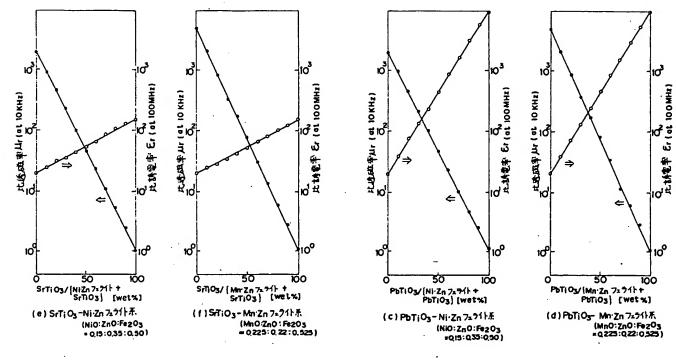
## 特開平2-232915 (5)

10



10 10 る たが年率 年(at 100MHz) 古 北部電子 & (at 100MHz) **共化路率山(10 KHz)** 克 大地部本上Julas 10KHz) 100 10 50 50 100 100 BaTiO3/{Ni-Zn 7x 51} + BaTiO3/ (wet%) BaTi O<sub>3</sub>/{MmZn 7= >1 } + BaTi O<sub>3</sub>} [wet%] (b)BgTiO3-Mn:Zn フェライト系 (Mn0:Zn0:Fe<sub>2</sub>O3 +0.225:0.22:0.525) (a) BaTiO3-Ni·Zn7±91ト系 (NiO:ZnO:Fe2O3 =015:Q35:050) 第3 図

第2図



第4 図

第5 図

第1頁の続き

®Int.Cl.5 識別記号 庁内整理番号 # C 04 B 35/26 Z 8924-4G 35/46 D 7412-4G H 7412-4G E 7412-4G H 01 F 15/00 C 6447-5E H 03 H 7/01 Z 7328-5J

個発 明 者 尾 野 幹 也 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 三菱鉱業セメント 株式会社セラミツクス研究所内

### 手続補正書

平成1年4月27日

特許庁長官 吉 田 文 較 殿

1.事件の表示

平成1年特許顯第52785号

2. 発明の名称

チップ型LC複合セラミックス部品

3 . 補正をする者

事件との関係 出願人

住所 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

名称 三菱鉱業セメント株式会社

代波者 藤 村 正 故

4.代理人

住所 〒101東京都千代田区神田須田町1丁目2番地

日邦・四国ビル3F

電話(03)253-4781

氏名 弁理士(7897) 倉 持 裕

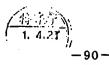


5.補正命令の日付

自 発

# 6.補正の対象

- (1) 明細書の[発明の詳細な説明]の棚
- 7. 補正の内容
  - (1) 可細書の第2页第14行目の[キャタシタ]を[キャパシタ]に訂正する。
  - (2) 同上第3頁第2行目の[同一面]を[同一面積]に れでする。
  - (3) 同上第5頁第2行目の[誘導性]を[誘電性]に訂正する。
  - (4)同上第6頁第4行目の[磁性誘導体]を[磁性誘電 体]に訂正する。
  - (5)同上第9頁第1~2行目の[キャパスタンス]を[キャパンタンス]に訂正する。



PAT-NO:

JP402232915A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02232915 A

TITLE:

CHIP TYPE LC COMPOSITE CERAMIC COMPONENT

PUBN-DATE:

September 14, 1990

INVENTOR-INFORMATION: NAME KITAHARA, NAOTO WADA, HIDEAKI KOSHIMURA, MASAMI ONO, MIKIYA

ASSIGNEE-INFORMATION:

COUNTRY

MITSUBISHI MINING & CEMENT CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP01052765

APPL-DATE:

March 7, 1989

INT-CL (IPC): H01G004/40, H01G004/12, C04B035/26, C04B035/46, H01F015/00

, H03H007/01

**US-CL-CURRENT: 361/320** 

### ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a composite ceramic component with a laminated ceramic substrate by a method wherein a composite ceramic material is formed with the mixed sintered body having permittivity and permeability and containing the ferrite of specific metal oxide and the dielectric compound of specific metal titanate.

CONSTITUTION: When the ferrite of metal oxide MFe<SB>3</SB>O<SB>4</SB>, having the metal element M containing one or more element selected from manganese, nickel, magnesium, cobalt, zinc and iron, and a mixed sintered body, having a permittivity of 2.0 or higher and permeability of 1 or higher and containing the dielectric compound consisting of one or more groups of barium

titanate, titanate and strontium titanate, are used as a composite ceramic material, a chip type LC composite ceramic component, having both capacitor function and induction function, is formed by a lamination substrate without putting together two kinds of lamination substrates.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio